



平成 27 年 1 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代 表 者 執行役社長 久田 眞佐男
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号
コード番号 8036 (東証第一部)
問い合わせ先 CSR・コーポレートコミュニケーション部長
横井 芳人 (電話: 03-3504-5138)

ボンディング装置事業における共同新設分割に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 22 日付けニュースリリース（「共同新設分割および新設会社の株式譲渡に関するお知らせ」）にて、当社と当社 100%子会社である株式会社日立ハイテクインスツルメンツ（以下、日立ハイテクインスツルメンツ）が、共同新設分割により新設会社を設立し、両社の半導体後工程装置事業（以下、ボンディング装置事業）を新設会社に承継（以下、本会社分割）させることを発表しましたが、本日、共同新設分割計画を決定しましたので、平成 26 年 12 月 22 日付けのリリースで未定としておりました事項について、下記の通りお知らせいたします。なお、変更箇所には下線を付しております。

記

1. 会社分割の目的

日立ハイテクグループでは、日立ハイテクインスツルメンツが培ってきた技術力・製品開発力を活かし、ボンディング装置事業の事業基盤強化や製品競争力の向上を図って参りました。

しかしながら、変化の激しい市場環境の中でお客様の期待に応えつつ安定的な収益を確保するためには、より一層スピーディーな事業運営が求められます。従って、ボンディング装置事業は経営効率の一層の向上を進めるために、新設会社であるファスフォードテクノロジー株式会社（以下、ファスフォードテクノロジー）に承継させることとしました。

なお、当社は、日立ハイテクインスツルメンツが保有することとなるファスフォードテクノロジーの全株式を、日立ハイテクインスツルメンツの剰余金配当として当社が取得した上、当社が保有することとなるファスフォードテクノロジーの全株式と併せて、平成 27 年 3 月 31 日付けで株式会社TYホールディングスに譲渡する予定です。

2. 会社分割の要旨

(1) 会社分割の日程

取締役会決議日（当社）	平成 26 年 12 月 22 日
株式譲渡契約締結日（当社）	平成 26 年 12 月 24 日
新設分割計画承認経営会議（当社）	平成 27 年 1 月 27 日
新設分割計画承認取締役会（日立ハイテクインスツルメンツ）	平成 27 年 1 月 28 日（予定）
新設分割計画承認株主総会（日立ハイテクインスツルメンツ） （会社法第 319 条第 1 項に基づく議決権を行使することができる株主全員の同意）	平成 27 年 3 月 13 日（予定）
分割期日（効力発生日）	平成 27 年 3 月 16 日（予定）

※当社は会社法第 805 条の規定に基づき、株主総会の承認を得ることなく行います。

(2) 会社分割の方式

当社および日立ハイテクインスツルメンツを新設分割会社とし、両社が共同で新設するファスフォードテクノロジーを新設分割設立会社とする共同新設分割です。

(3) 会社分割に係る割当ての内容

ファスフォードテクノロジーは、本会社分割に際して普通株式 2,000 株を発行し、当社に対して 650 株、日立ハイテクインスツルメンツに対して 1,350 株を割当交付します。
日立ハイテクインスツルメンツは、本会社分割に際して、ファスフォードテクノロジーから交付を受けた普通株式 1,350 株全てを剰余金配当として当社に交付します。

(4) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

当該事項はありません。

(5) 会社分割により増減する資本金

当該事項はありません。

(6) 新設分割設立会社が承継する権利義務

ファスフォードテクノロジーは、効力発生日における当社および日立ハイテクインスツルメンツの本事業に係る資産、債務その他の権利義務について、平成 27 年 1 月 28 日付け共同新設分割計画書に定めたものをそれぞれ承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降において、当社および日立ハイテクインスツルメンツならびにファスフォードテクノロジーが履行する債務について、その履行の確実性に問題はないと判断しております。

3. 会社分割の当事会社の概要

	新設分割会社	新設分割会社	新設分割設立会社 (設立時点の予定)
(1) 名称	株式会社日立ハイテクノロジーズ	株式会社日立ハイテクインスツルメンツ	ファスフォードテクノロジー株式会社
(2) 所在地	東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号	埼玉県熊谷市妻沼西一丁目 6 番地	山梨県南アルプス市下今諏訪 610 番地 5
(3) 代表者の役職・氏名	執行役社長 久田 眞佐男	取締役社長 河崎 勝浩	取締役社長 富士原 秀人
(4) 事業内容	電子デバイスシステム、ファインテックシステム、科学・医用システムの設計、製造、販売、および産業・IT システム、先端産業部材の販売	半導体製造装置の設計、製造、販売、修理および保守等のサービスなど	半導体製造装置の設計、製造、販売、修理および保守等のサービスなど
(5) 資本金	7,938 百万円	450 百万円	100 百万円
(6) 設立年月日	昭和 22 年 4 月 12 日	平成 6 年 12 月 1 日	平成 27 年 3 月 16 日
(7) 発行済株式数	137,738,730 株	9,000 株	2,000 株
(8) 決算期	3 月末	3 月末	3 月末
(9) 大株主および持株比率	・株式会社日立製作所 51.64% ・日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.11% ・日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.06% ・日立ハイテクノロジーズ社員持株会 1.46% ・818517 ノムラルクスマルチカレンシジエイピストクリド 1.19%	・株式会社日立ハイテクノロジーズ 100%	・株式会社日立ハイテクノロジーズ 32.5% ・株式会社日立ハイテクインスツルメンツ 67.5%

(10) 直前事業年度の財政状態および経営成績 (単位：百万円。特記しているものを除く。)		
	株式会社日立ハイテクノロジーズ(連結)	株式会社日立ハイテクインスツルメンツ
決算期	平成 26 年 3 月期	平成 26 年 3 月期
純資産	272,968	▲9,672
総資産	494,934	8,196
1株当たり 純資産(円)	1,981.00	▲1,074,652.49
売上高	639,116	11,425
営業利益	30,431	▲894
経常利益	31,102	▲937
当期純利益	18,032	▲628
1株当たり 当期純利益(円)	131.11	▲69,797.65

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

ボンディング装置事業における当社の販売機能および日立ハイテクインスツルメンツの設計、製造、サービス機能

(2) 分割する部門の経営成績(平成 26 年 3 月期実績)

①株式会社日立ハイテクノロジーズ

(単位：百万円)

	分割する事業の実績(A)	全体(B)	比率(%) (A)/(B)×100
売上高	7,580	390,806	1.9%

②株式会社日立ハイテクインスツルメンツ

(単位：百万円)

	分割する事業の実績(A)	全体(B)	比率(%) (A)/(B)×100
売上高	6,604	11,425	57.8%

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成 26 年 3 月期実績)

①株式会社日立ハイテクノロジーズ

(単位：百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,328	流動負債	955
固定資産	0	固定負債	60
合計	1,328	合計	1,015

②株式会社日立ハイテクインスツルメンツ

(単位：百万円)

資産		負債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,257	流動負債	736
固定資産	1,412	固定負債	490
合計	2,668	合計	1,226

※承継する資産および負債の金額は、分割予定日の前日までの増減を加除した上で確定されます。

5. 会社分割後の当社および新設会社の状況

本会社分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本会社分割の対象となっている事業をのぞく）、資本金および決算期の変更はありません。新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期については、「3. 会社分割の当事会社の概要」をご参照ください。

6. 今後の見通し

本会社分割による当社の連結業績への影響は軽微であります。

以上